



PLOTECH

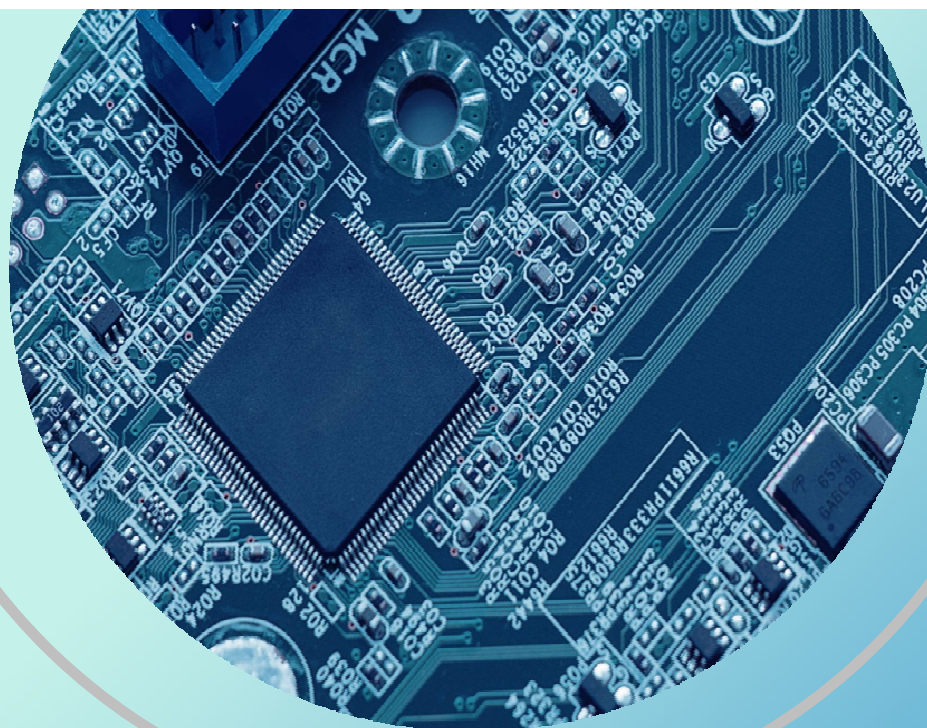
柏承科技股份有限公司

2023法人說明會

1 | 2023營運成果

近期重要事情摘要 | 2

CONTENTS 目錄

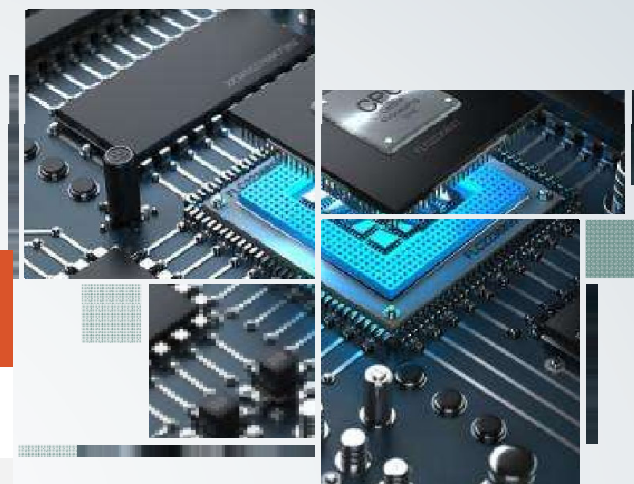


01

2023第三季營運成果

01 / 綜合損益表

項目	1Q22	2Q22	3Q22	2022 Q1-Q3	1Q23	2Q23	3Q23	2023 Q1-Q3	QoQ	YoY
營業收入淨額	905	922	754	2,581	508	709	727	1,944	2.5	(24.7)
營業毛利率%	14.9	19.8	15.8	17.0	(2.2)	(6.5)	1.5	(2.4)	8.0	(19.2)
營業費用	121	127	140	388	89	102	100	291	(2.0)	(25.0)
營業淨利率%	1.5	6.1	(2.8)	2.0	(26.3)	(13.0)	(13.5)	(17.6)	(0.5)	(19.2)
營業外收支	(11)	(29)	0	(40)	(15)	3	3	(9)	0.0	(77.3)
本期稅後淨利	(3)	12	(22)	(13)	(124)	(58)	(79)	(261)	36.2	1,908
純益率%	(0.3)	1.3	(2.9)	(0.6)	(24.4)	(8.2)	(10.9)	(14.5)	(2.7)	(13.8)
每股盈餘 (元)	(0.02)	0.09	(0.17)	(0.10)	(0.98)	(0.46)	(0.64)	(2.08)	39.1	1,980

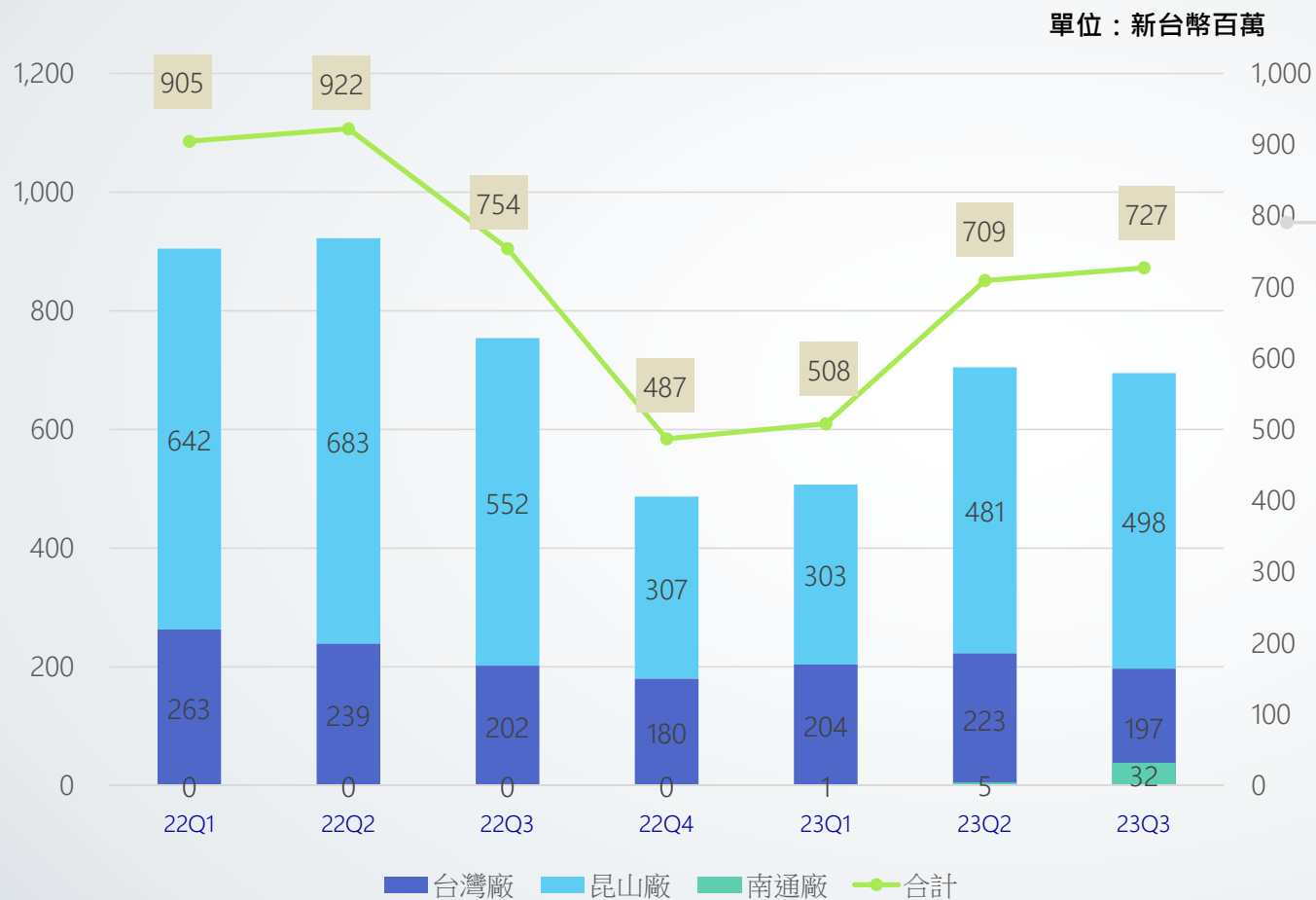


單位：新台幣百萬

QoQ：Q3 vs Q2

Y o Y：(2023Q1~Q3) vs (2022Q1~Q3)

01 營收分析



2023年Q1-Q3昆山廠+臺灣廠+南通廠，營收比2022年同期下降25%



昆山廠

- 2023年消費性電子產品市場低迷，客戶終端需求減少，訂單下滑，2023年Q1-Q3比2022年同期下降32%

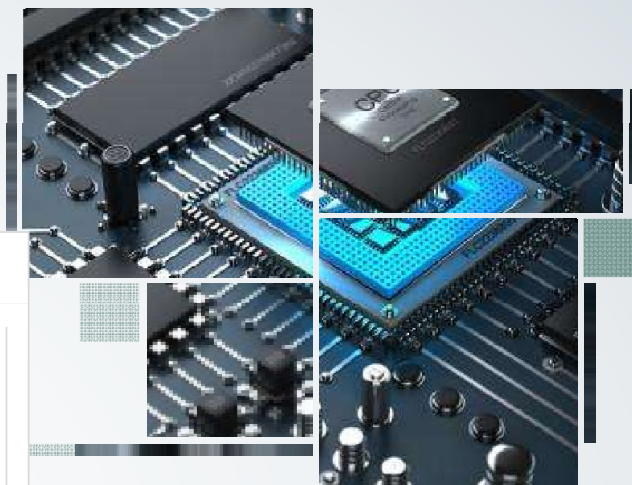
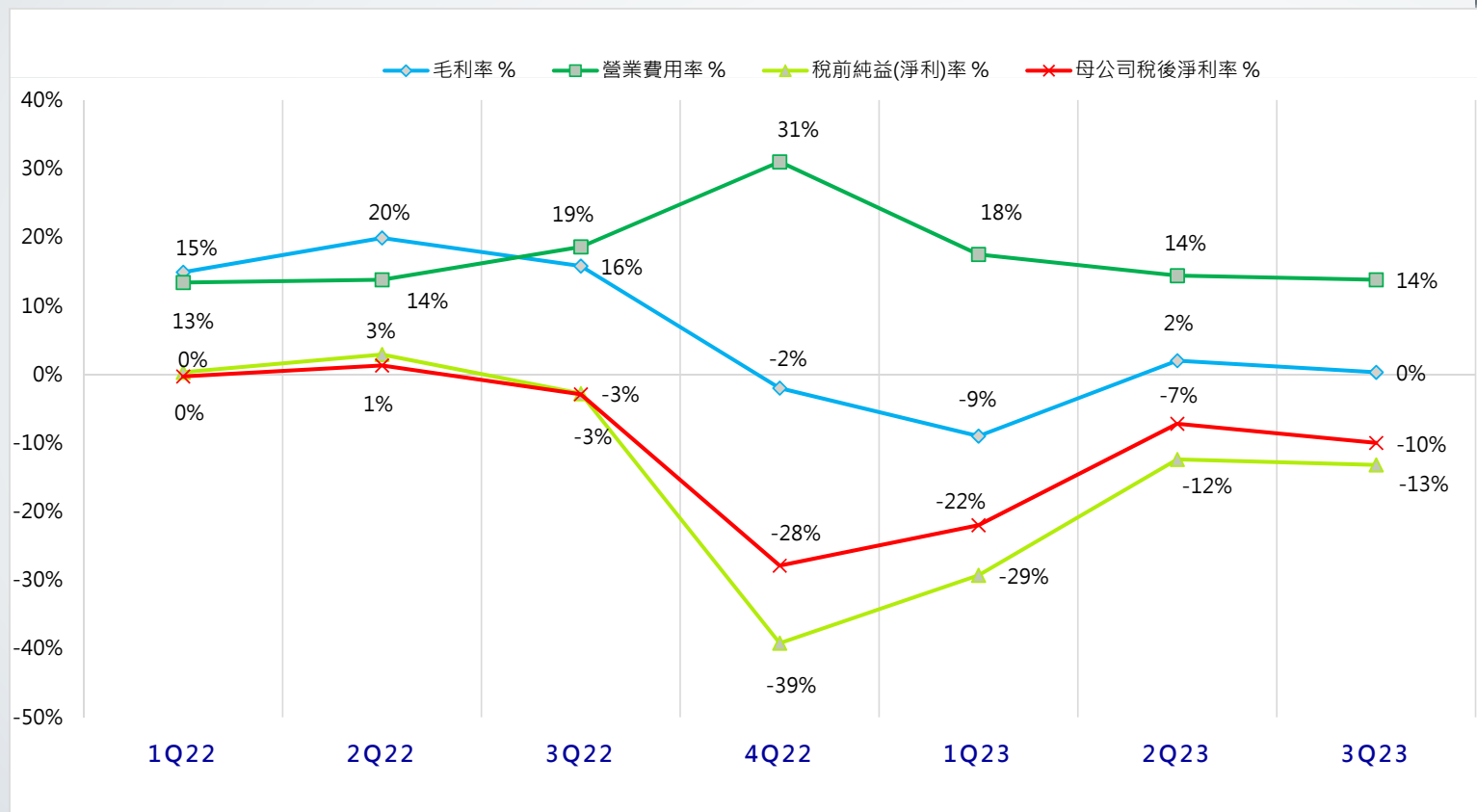


臺灣廠

2023Q1-Q3與2022年度同期營收相比，下降11%

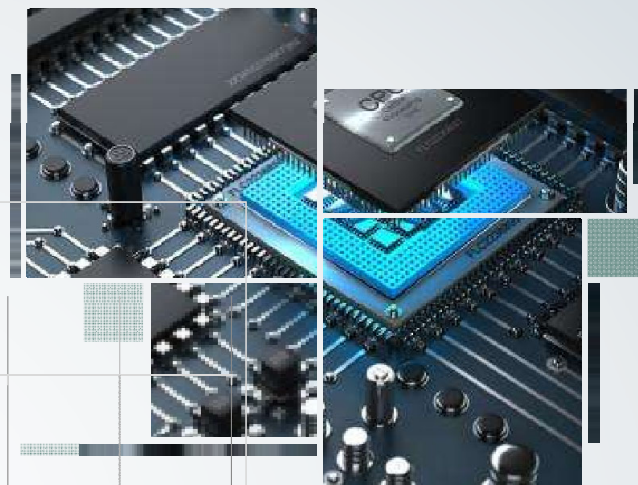
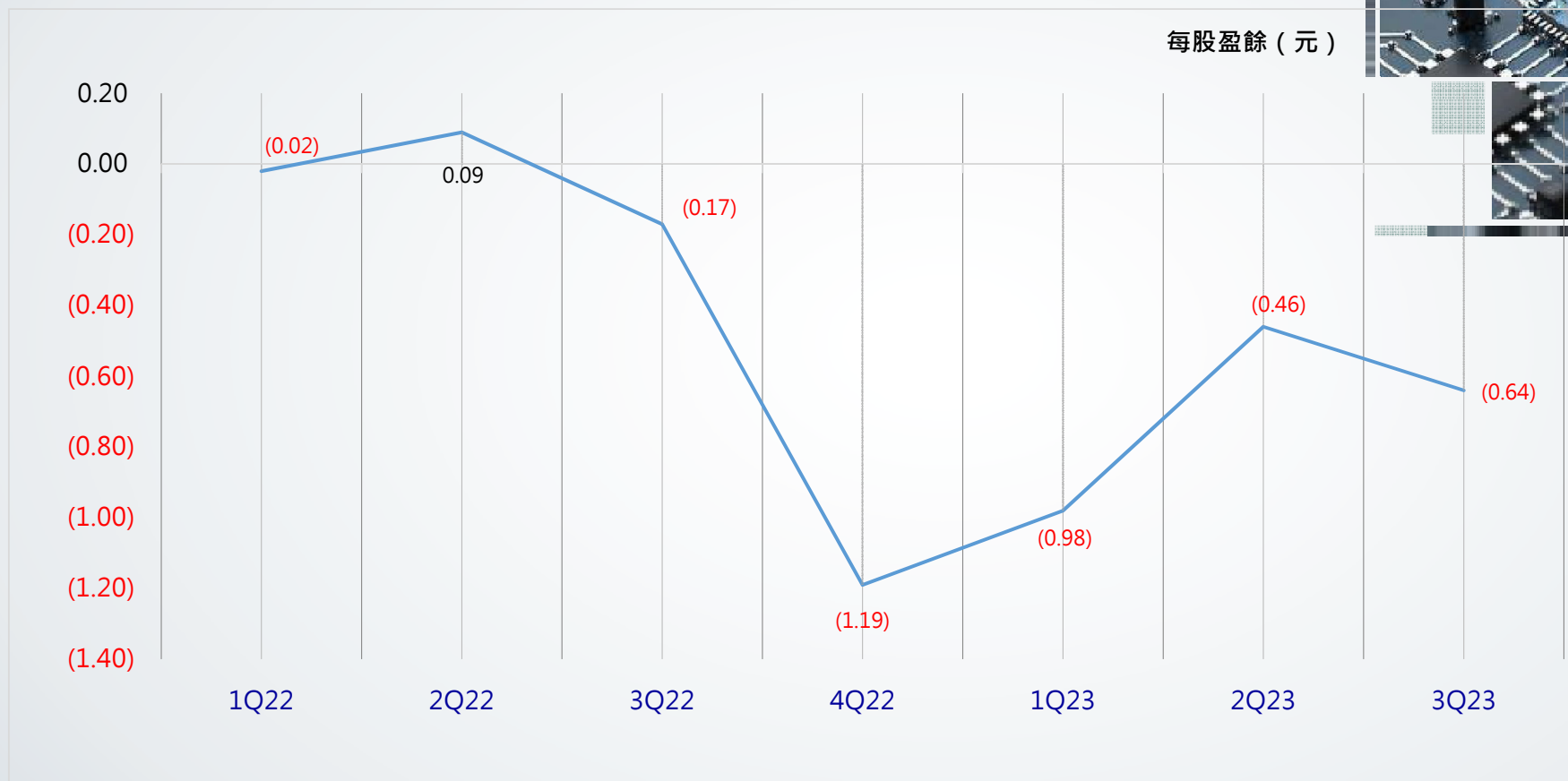
01

合併獲利指標



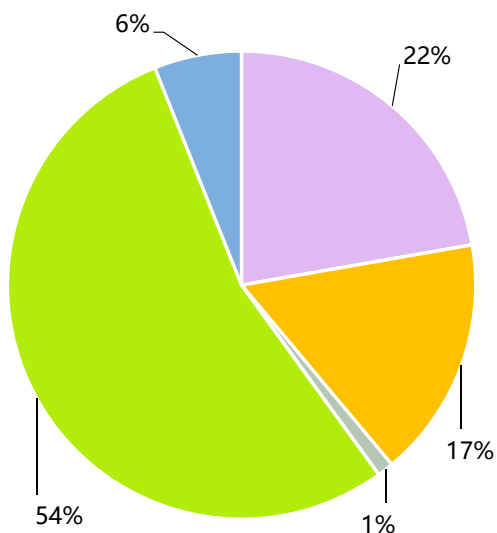
01

合併每股盈餘



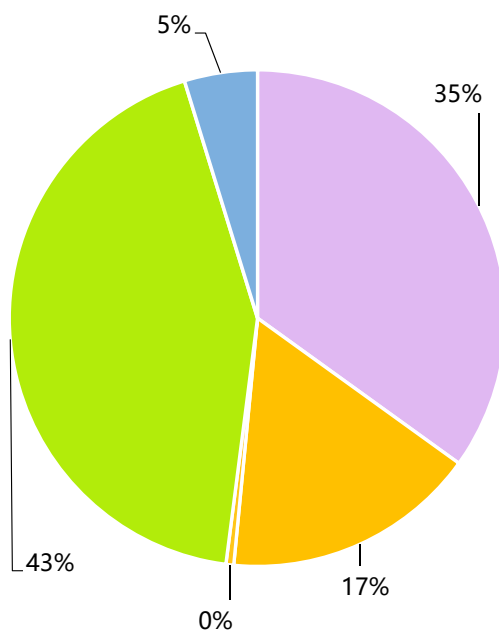
01 / 產品個別結構-昆山廠

2022全年製程別營收%



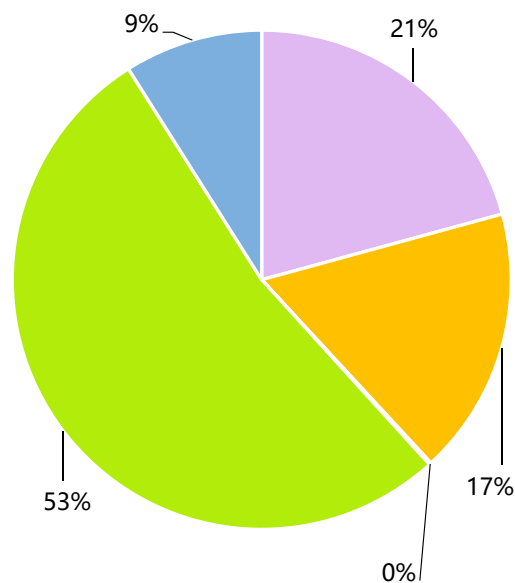
■ 傳統板
 ■ HDI一階
 ■ HDI RF
 ■ HDI二階
 ■ HDI Anylayer

1Q23製程別營收%



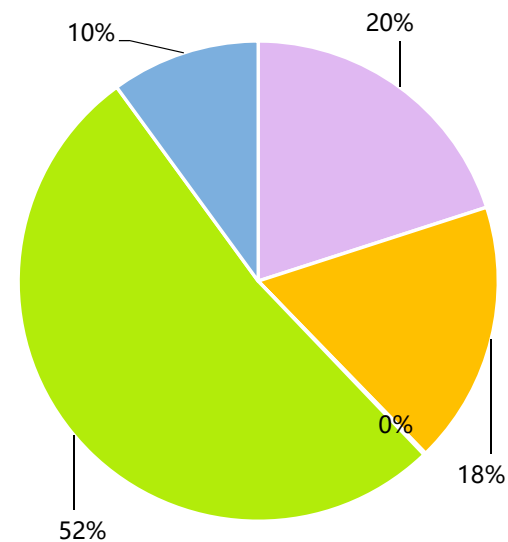
■ 傳統板
 ■ HDI一階
 ■ HDI RF
 ■ HDI二階
 ■ HDI Anylayer

2Q23製程別營收%



■ 傳統板
 ■ HDI一階
 ■ HDI RF
 ■ HDI二階
 ■ HDI Anylayer

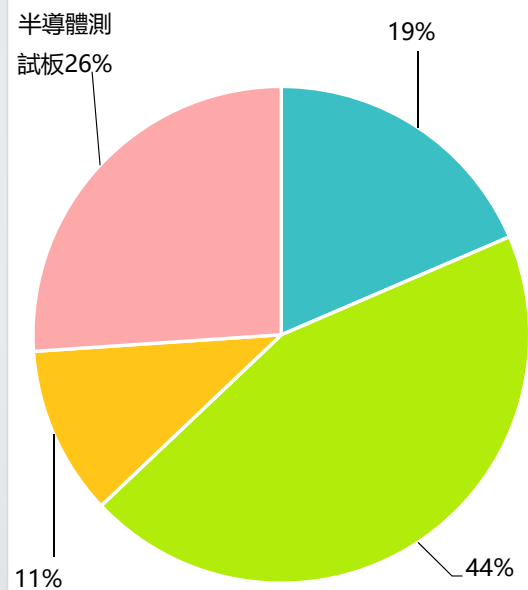
3Q23製程別營收%



■ 傳統板
 ■ HDI一階
 ■ HDI RF
 ■ HDI二階
 ■ HDI Anylayer

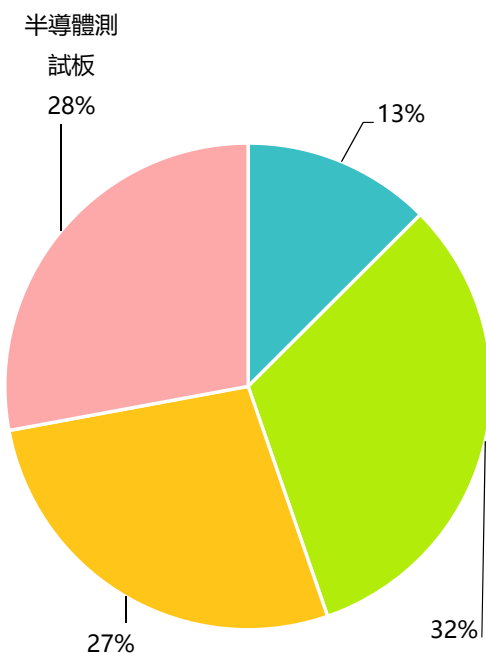
01 / 產品個別結構 - 臺灣廠

2022全年製程別營收%



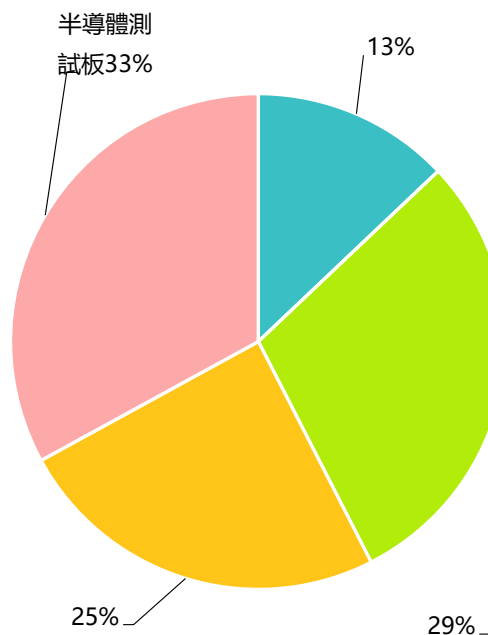
■ 樣品 ■ 量產 ■ 商品 ■ 半導體測試板

1Q23製程別營收%



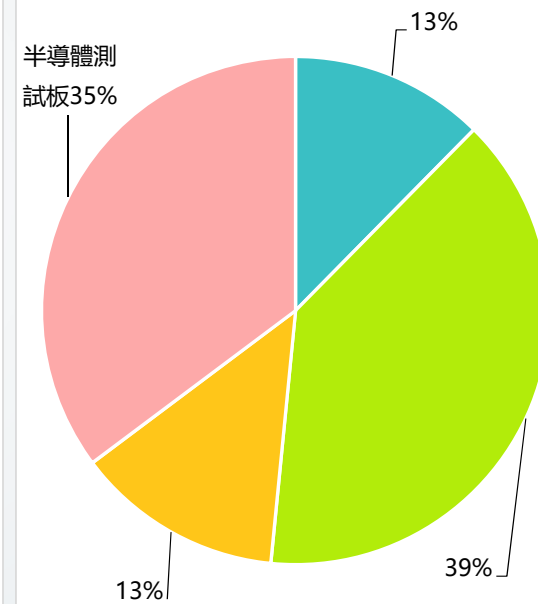
■ 樣品 ■ 量產 ■ 商品 ■ 半導體測試板

2Q23製程別營收%

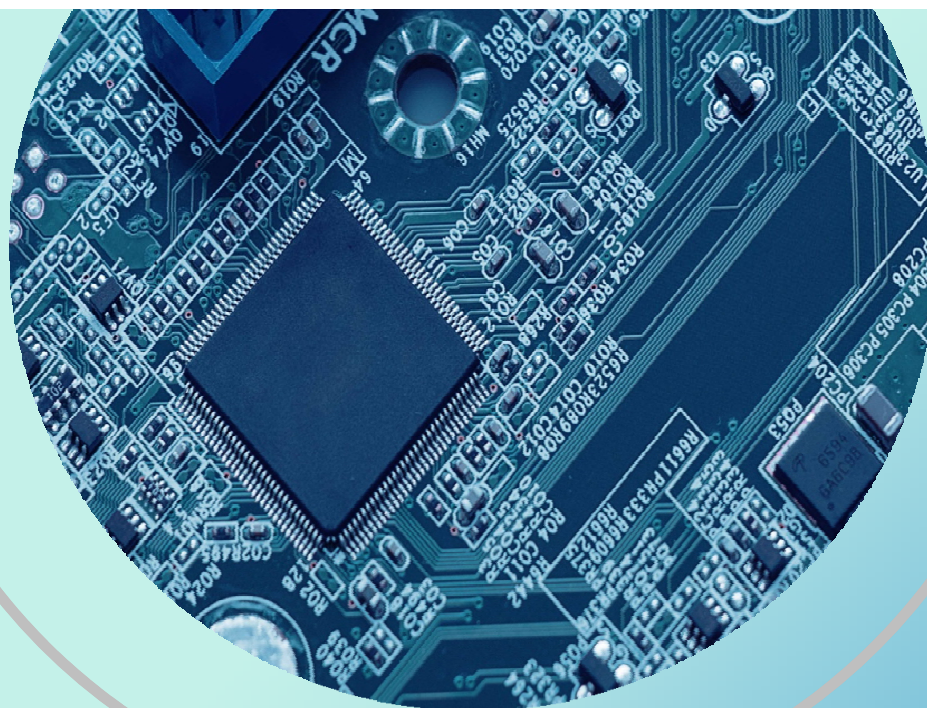


■ 樣品 ■ 量產 ■ 商品 ■ 半導體測試板

3Q23製程別營收%



■ 樣品 ■ 量產 ■ 商品 ■ 半導體測試板



02

近期重要事情摘要

02 市場開發

HDI 高階電路板-LED

- 產品運用：Mini LED , Mirco LED
- 目前進度：小量生產

HDI 高階電路板-載板

產品運用：MCU, CSP, FCCSP
目前進度：樣品階段

開發產品

HDI 高階電路板： 5G 產品(通訊模組、IOT)

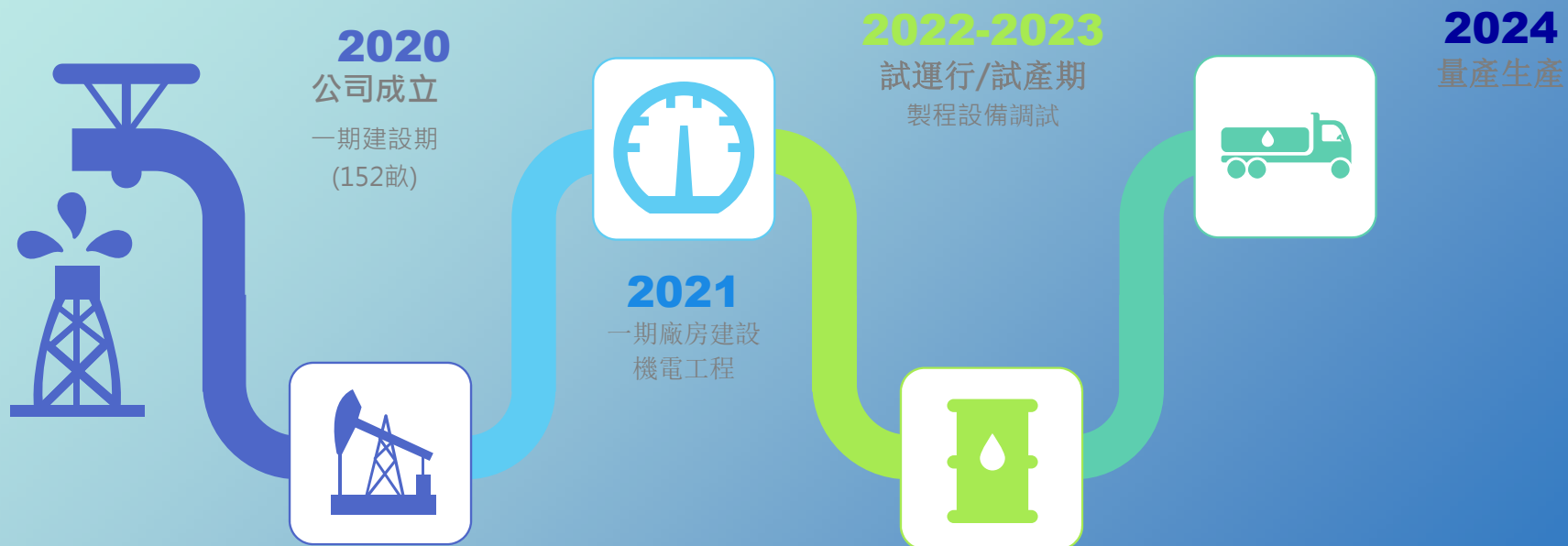
產品運用：5G手機、5G Iot模組、5G 車聯網產品、
光通訊高速模組產品
目前進度：量產生產 持續開發

HDI 軟硬結合板 ：掃碼鏡頭，攝像頭鏡頭

產品運用：耳機，手錶，手環，指環，AR/VR
目前進度：量產生產 持續開發

02

南通柏承投產時間



Q & A